（上接113版）

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

附表1-1：

募集资金使用情况对照表－以简易程序向特定对象发行股票募集资金

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年以简易程序向特定对象发行股票												
募集资金到账日期	2023年3月29日												
本年度投入募集资金总额	5,076.38												
已累计投入募集资金总额	19,490.06												
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
宁波安集化学机械抛光液建设项目	生产建设	否	11,950.00	11,950.00	11,950.00	3,609.74	12,103.57	153.57	101.29	2026年3月	不适用	不适用	否
安集科技上海金桥生产线自动化项目	运营管理	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	825.53	3,457.89	-1,042.11	76.84	2026年3月	不适用	不适用	否
安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目	运营管理	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	641.11	1,496.76	-3.24	99.78	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	2,763.62	2,411.91	2,411.91	-	2,431.84	19.93	100.83	不适用	不适用	不适用	否
合计			20,713.62	20,361.91	20,361.91	5,076.38	19,490.06	-871.84	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年度，公司无此情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年度，公司无此情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2025年度，公司无此情况。												
募集资金结余的金额及形成原因（注2）	2025年度，公司无此情况。												
募集资金其他使用情况	2025年3月4日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”的建设期延长至2026年3月，该项目已于2026年3月达到可使用状态并结项。												

注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。募集资金本年度实际投入金额大于承诺投资总额的原因为募集资金账户含利息收入。

注2：公司经2026年3月26日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026年3月31日的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”予以结项，并将节余募集资金合计人民币11,420,712.58元永久补充流动资金。

附表1-2：

募集资金使用情况对照表－2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2025年4月11日												
本年度投入募集资金总额	43,588.65												
已累计投入募集资金总额	43,588.65												
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
上海安集集成电路材料基地项目	生产建设	否	34,850.00	34,850.00	34,850.00	12,040.10	12,040.10	-22,809.90	34.55	2028年4月	不适用	不适用	否
上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目	运营管理	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-9,000.00	-	2028年4月	不适用	不适用	否
宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目	生产建设	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,391.11	2,391.11	-3,608.89	39.85	2028年4月	不适用	不适用	否
安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目	研发项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	8,346.56	8,346.56	-2,653.44	75.88	2028年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	22,200.00	20,810.89	20,810.89	20,810.89	20,810.89	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			83,050.00	81,660.89	81,660.89	43,588.66	43,588.66	-38,072.23	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年度，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币163,370,258.81元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2502761号）。截至2025年12月31日止，前述募集资金置换已实施完成。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年度，公司无此情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2025年度，公司无此情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	2025年度，公司无此情况。												
募集资金其他使用情况	2025年度，公司无此情况。												

注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

证券代码：688019　证券简称：安集科技　公告编号：2026-026

安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于2026年度预计为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
宁波安集微电子科技有限公司（以下简称“宁波安集”）	50,000万元	-	不适用：本次为年度担保预计	否
宁波安集股权投资有限公司（以下简称“宁波安集投资”）		-		
台湾安集微电子科技有限公司（以下简称“台湾安集”）		3,000万元		
上海安集电子材料有限公司（以下简称“安集电子材料”）		-		
北京安集微电子科技有限公司（以下简称“北京安集”）		-		
ANJI MICROELECTRONICS PTE.LTD.（以下简称“新加坡安集”）		-		

截至本公告日，公司对子公司台湾安集出具承诺对债务承担连带保证责任，担保金额为人民币3,000万元（最高额担保），该担保协议项下发生实际担保债务金额为人民币60万元。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	3,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.85
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2026年度公司拟为全资子公司宁波安集、宁波安集投资、台湾安集、安集电子材料、北京安集及新加坡安集申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币50,000万元，担保方式包括保证、抵押、质押等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。

公司董事会授权公司管理团队根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范围内办理提供担保的具体事项并签署相关法律文件，担保额度及授权经公司董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第三十次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供担保的议案》。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代理人办理担保手续的签批工作和签署上述担保事项相关的法律文件。上述事项无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
安集科技	宁波安集微电子科技有限公司	100	26.41	0	50,000	14.16	自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止	否	否
	宁波安集股权投资有限公司	100	3.50	0					
	台湾安集微电子科技有限公司	100	67.81	60					
	上海安集电子材料有限公司	100	0.19	0					
	北京安集微电子科技有限公司	100	38.90	0					
	ANJI MICROELECTRONICS PTE.LTD.	100	1.54	0					

（四）担保额度调剂情况

在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况在各子公司之间调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	宁波安集微电子科技有限公司	全资子公司	公司持有100%股权	91330206MA2916K00K
法人	宁波安集股权投资有限公司	全资子公司	公司持有100%股权	91330206MA2J4P6U19
法人	台湾安集微电子科技有限公司	全资子公司	公司持有100%股权	42601906
法人	上海安集电子材料有限公司	全资子公司	公司持有100%股权	91310120MA7DR6DX8D
法人	北京安集微电子科技有限公司	全资子公司	公司持有100%股权	91110400MA04DF117X
法人	ANJI MICROELECTRONICS PTE.LTD.	全资子公司	公司持有100%股权	202213027E

（二）主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
宁波安集微电子科技有限公司	58,638.15	15,488.24	43,149.91	40,190.33	13,700.94
宁波安集股权投资有限公司	22,616.45	792.02	21,824.43	-	1,302.80
台湾安集微电子科技有限公司	3,040.73	2,061.96	978.77	3,151.70	81.94
上海安集电子材料有限公司	46,187.68	86.12	46,101.56	-	260.03
北京安集微电子科技有限公司	303.40	118.02	185.39	687.91	58.41
ANJI MICROELECTRONICS PTE.LTD.	1,879.72	28.96	1,850.76	332.86	-1,989.89

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司2026年度发展计划进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第三十次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司2026年度对子公司担保额度预计事项充分考虑了公司的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司2026年度对子公司担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司及其子公司对外担保余额为3,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.85%和0.60%。无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码：688019　证券简称：安集科技　公告编号：2026-022

安集微电子科技（上海）股份有限公司
2025年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，不送红股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

● 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,992,984,815.57元，2025年当年实际可供股东分配利润为639,458,767.34元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为783,648,337.86元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2026年4月15日，公司总股本为174,994,396股，若以此计算合计拟派发现金红利87,497,198.00元（含税）。本年度公司现金分红占母公司当年实现可分配利润比例约13.68%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的11.17%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2026年4月15日，公司总股本174,994,396股，合计转增52,498,319股，转增后公司总股本将增加至227,492,715股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，具体如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	87,497,198.00	58,090,709.25	34,631,673.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	783,648,337.86	533,643,641.69	402,733,766.50
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,992,984,815.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	180,219,580.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	573,341,915.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	180,219,580.90		
现金分红比例（%）	31.43%		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	1,014,079,914.98		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	5,577,104,248.05		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	18.18%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为783,648,337.86元。拟分配的现金红利总额为87,497,198.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类标准，公司所处行业为半导体材料行业。

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。

公司自成立之初就将自己定位为以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料供应伙伴，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，公司建立了核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，保障长期供应的可靠性。公司成功搭建了“化学机械抛光液－全品类产品矩阵”“功能性湿电子化学品－领先技术节点多产品线布局”“电镀液及添加剂－强化及提升电镀高端产品系列战略供应”及“核心原材料建设－提升自主可控战略供应能力”具有核心竞争力的“3+1”技术平台及应用领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，并且拓展和强化了电化学沉积领域的技术平台，产品覆盖多种电镀液及添加剂。通过对上游核心原材料的持续深入研发，从性能优化、寻找开发新产品的技术可行性等方面进一步提升产品竞争力，获得更多合作机会的可能。

（二）上市公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2025年度，公司实现营业收入250,421.79万元，同比增长36.47%；实现归属于母公司所有者的净利润783,648.37万元，同比增长46.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润69,655.35万元，同比增长32.36%。公司盈利能力不断增强，整体财务状况稳健、良好。

报告期内，公司紧扣2025年半导体行业技术迭代趋势，保持高强度研发投入，有序推进各类产品研发、测试与验证工作，持续强化技术储备，为公司未来增长积蓄强劲动能。研发投入持续加大且高效，全年研发投入44,470.13万元，占营业收入比例为17.76%，始终坚守高端半导体材料领域战略定位，聚焦芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，围绕液体与固体表面的微观处理核心技术，持续深耕、迭代升级，公司搭建的“3+1”技术平台及相关应用领域得到进一步完善布局，全面提升公司核心技术竞争力，为产品迭代、市场拓展提供坚实的技术支撑。最近三年，公司研发费用分别为23,661.27万元、33,276.59万元、44,470.13万元，累计占最近三年累计营业收入的比例为18.18%，研发投入持续保持在较高水平。

2026年，公司将坚持“立足中国，服务全球”的战略定位，坚定不移秉持“客户至上”的核心理念，通过共享价值和责任，提供具有竞争力的性能、质量和成本满足或超越客户期望的产品以及全面、差异化的服务，提高为客户解决问题的能力和效率，提高客户满意度，致力于使公司成为客户的首选合作伙伴。同时，将进一步加强在关键原材料和关键技术方面的能力建设，利用人工智能等技术工具加速创新和产品开发，以巩固和加强公司的竞争优势；通过国内外持续扩张的市场份额，以及由技术进步和成本效益驱动的商业机会，实现持续的稳健增长，以满足中期和长期的企业目标。

公司目前处于快速发展的重要阶段，需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点、经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

（三）上市公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司2025年度未分配利润将转入下一年度，主要用于扩大国内市场份额，提升海外业务发展的软硬件资源配置，同时，持续进行研发投入，进一步加强核心原材料自主可控供应能力建设及公司生产经营能力建设，从而实现公司价值的不断增长，最大限度维护股东利益。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

（四）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司高度重视中小股东的合法权益，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供充分便利。公司建立及健全了多渠道的投资者交流机制，中小股东可通过投资者热线、邮箱、上证“e互动”平台、业绩说明会等多种渠道对现金分红政策提出意见和建议。同时，公司股东会将提供现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东参与股东会决策提供便利。

（五）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来，公司将在努力做好主营业务经营的同时，继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在严格遵守相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第三十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交至公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码：688019　证券简称：安集科技　公告编号：2026-025

安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事、高管薪酬管理办法》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）独立董事：

公司2026年独立董事津贴标准为15万元整（含税）/年，按月发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事：

1、未在公司内部任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，可以由公司结合其履职情况和贡献等情况发放一定的津贴；

2、在公司内部任职的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》，根据其在公司的具体岗位、职责绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。

（三）高管薪酬方案：

公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》，根据其在公司的具体岗位、职责绩效考核结果等领取薪酬。

（四）绩效薪酬的发放：

董事、高管绩效薪酬的发放：与公司月度、季度及年度经营情况等综合指标完成情况以及绩效评价相挂钩，绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，至少30%以上比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后根据结果支付。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月3日召开第三届薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》由于两名薪酬与考核委员会回避表决，薪酬与考核委员会人数不足，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》由于6名关联董事回避表决，董事审议人数不足，将直接提交给股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》2名关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

安集微电子科技（上海）股份有限公司
2026年“提质增效重回报”专项行动方案

为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日发布了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，并于2025年8月26日披露了《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025年度，公司在经营成效、研发进展、公司治理、投资者交流与回报等方面均按计划积极实施，取得了较好的成果，进一步强化了公司经营质量，并在资本市场建立了积极正面的良好形象。

为进一步提高经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效，持续提升公司质量和投资价值，公司特此制定《2026年“提质增效重回报”专项行动方案》，对2025年行动方案实施情况进行总结，并明确2026年行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，夯实产品布局，持续提升盈利能力

公司作为一家以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料企业，致力于高增长率和高功能材料的研发和产业化，继续坚定“3+1”技术平台及应用领域的布局规划，进一步加速产品创新和工艺开发，在化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂和上游关键原材料建设方面进一步夯实和发展。

2025年度，公司紧紧围绕“实现可持续稳健增长”和“成为客户首选合作伙伴”的年度目标，聚焦核心产品市场拓展与份额提升，面对半导体行业结构性复苏、赛道分化加剧及外部环境复杂多变等多重挑战，公司坚持既定发展战略与市场布局，稳步推进各项经营工作，在新订单获取、新客户开拓、新应用拓展及新产品客户导入等方面均取得积极成效，产品结构与客户结构持续优化，市场渗透力度与覆盖广度不断提升。公司始终坚持“客户至上”理念，深化与核心客户的战略合作，紧跟客户需求与产能释放节奏，推动多款重点产品顺利进入量产上量阶段，有效支撑营业收入实现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入250,421.79万元，同比增长36.47%，其中化学机械抛光液营业收入同比增长32.06%，持续保持稳健增长势头；功能性湿电子化学品营业收入同比增长63.73%，业务规模快速提升，呈现出良好的成长态势；集成电路大马士革电镀液及添加剂实现量产突破，关键产业化节点如期达成，为后续市场拓展奠定坚实基础。实现归属于母公司所有者的净利润783,648.37万元，同比增长46.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润69,655.35万元，同比增长32.36%。

2026年，公司将通过共享价值和责任，提供具有竞争力的性能、质量和成本满足或超越客户期望的产品以及全面、差异化的服务，提高为客户解决问题的能力和效率，提高客户满意度，致力于使公司成为客户的首选合作伙伴。同时，通过国内外持续扩张的市场份额，以及由技术进步和成本效益驱动的商业机会，实现持续的稳健增长，以满足中期和长期的企业目标。

二、持续加大研发投入，提升技术创新能力

公司始终秉承“研发创新驱动企业发展”的理念，持续研发投入，不断提升研发创新能力，加大市场开拓力度。公司围绕液体与固体表面的微观处理技术，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，成功搭建“3+1”技术平台及应用领域，全面提升公司核心竞争力：“化学机械抛光液－全品类产品矩阵”“功能性湿电子化学品－领先技术节点多产品线布局”“电镀液及添加剂－强化及提升电镀液高端产品系列战略供应”及“核心原材料建设－提升自主可控战略供应能力”。

2025年全年研发投入44,470.13万元，占营业收入比例为17.76%。公司始终坚守高端半导体材料领域战略定位，聚焦芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，围绕液体与固体表面的微观处理核心技术，持续深耕、迭代升级，公司搭建的“3+1”技术平台及相关应用领域得到进一步完善布局，全面提升公司核心技术竞争力，为产品迭代、市场拓展提供坚实的技术支撑。

研发项目按计划推进：化学机械抛光液板块，公司继续致力于实现全品类产品线在新技术、新应用的布局和覆盖：报告期内，进一步提升产品晶圆级量产效率，部分成熟产品实现自我迭代并导入顺利，金属栅极抛光液在持续上量，抛光液品类覆盖率进一步提升；同时，公司紧跟客户需求，积极开发新材料和特殊工艺用化学机械抛光液，在3D/2.5D IC领域取得突破，保持产品先发优势。功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用等高端功能性湿电子化学品产品领域：报告期内，公司进一步丰富湿电子化学品产品系列的开发和导入，持续在先进技术节点应用领域布局，获得多家海内外客户测试机会，部分产品在海外客户显现出竞争优势，进展顺利，并有多款产品在多家客户上量及供应稳定，营业收入增长较为明显。电镀液及添加剂板块，公司继续强化反提升电镀高端产品系列战略供应，产品已覆盖多种电镀液及添加剂：报告期内，电镀液本地化供应进展顺利，持续上量；集成电路大马士革电镀液及添加剂进入量产阶段，实现销售；先进封装锡银电镀液及添加剂以及硅通孔电镀液及添加剂开发及验证按计划进行。在建立核心原材料自主可控供应方面，参股公司开发的多款硅溶胶产品在功能性、稳定性和产出方面有明显提升，已应用在公司多款抛光液产品中并实现量产销售；自研自产的磨料在品类、形貌、功能等方面得到进一步拓展与丰富，应用在公司产品中的测试论证进展顺利，多款产品已通过客户端的验证并实现量产供应，部分产品在重要客户实现销售，随着公司高端纳米磨料制备技术的进一步熟练掌握，上游原材料自主可控能力大大加强，随着在关键原材料领域的持续深耕，公司技术成果转化能力全面提升，持续保障了公司产品长期供应的安全性与可靠性，更进一步巩固了公司的核心竞争优势。

公司坚持研发创新的同时，不断完善自主知识产权的布局，截至2025年12月31日，公司及其子公司共获得308项发明专利授权，其中中国大陆209项、中国台湾75项、美国10项、法国5项、新加坡3项、韩国6项；另有383项发明专利申请已获受理，1项实用新型专利申请已获受理。

2026年，进一步加强在关键原材料和关键技术方面的能力建设，利用人工智能等技术工具加速创新和产品开发，以巩固和加强公司的竞争优势，并且在选定的行业和技术领域中寻找并购增长的机会，并探索对公司未来有可能性的孵化技术以